[JSPE-56-09] '90-09-1683



# カルコゲナイド光ファイバを用いた赤外線輻射 温度計による常圧焼結 SiC の研削温度測定\*

上田隆司\*\* 山田啓司\*\*\* 杉田忠彰\*\*

**Key words** : grinding temperature, silicon carbide, chalcogenide optical fiber, infrared radiation pyrometer

# 1. 緒 言

前報<sup>1)</sup> では石英光ファイバより長波長の赤外線を伝 送できるふっ化物光ファイバと高速光電変換素子 InSb を組み合わせた赤外線輻射温度計を用いること により,常圧焼結 $Si_3N_4$ を研削加工したときの研削 表面層の温度分布を測定することに成功した.ところ が,同じ温度計を常圧焼結SiCの研削温度測定に適 用したところ,SiC は $Si_3N_4$ よりはるかに被削性がよ いことから温度が上がらず(付録参照),約100°C 以 上しか測定できないこの温度計では精度良く測定する ことができなかった<sup>†</sup>.

そこで、本研究ではふっ化物光ファイバの代わりに さらに長波長の赤外線を伝送できるカルコゲナイド光 ファイバを用いて温度計の改善を試みると共に、SiC 内の研削温度測定に適用してみた。

# 2. 研究方法

#### 2.1 温度計

カルコゲナイド光ファイバは周期律表6B族元素 S, Se, Te を主成分とするカルコゲナイドガラスをコ ア材としたファイバであり,表1にその特性値を示 す<sup>2)</sup>. 石英やふっ化物ガラスを用いたファイバはコア クラッド構造をしているのに対し,カルコゲナイド光 ファイバはコアをテフロンでコーティングしており, このテフロンがクラッドの役目も果たしている. ま た,コア径もこれまでのファイバが 50 μm であった のに対し,強度の低さをカバーするため 320 μm と大 きくしている. このため,感温面積が大きくなること から使用範囲は限定されるが,本研究の場合大きな問 題ではない. 図1 は伝送損失 (測定値)であり,ふっ 化物光ファイバと比較している.ふっ化物光ファイバ に比べ全体的に損失がほぼ1けた程度大きくなってい るが, 6 μm 以上の赤外線まで伝送することができる.

温度計の基本構造はこれまでと同じであり,測定対 象物から輻射された赤外線を光ファイバで受光して伝 送し,集光レンズを介して InSb セルに導き,電気信 号に変換する構造をしている.したがって,この温度 計を用いて温度 T の黒体から輻射される赤外線エネ ルギーを測定したとき得られる相対感度  $\Lambda$  は黒体の 輻射能を $J(\lambda, T)$ ,光ファイバの分光透過率を $F(\lambda)$ , 集光レンズの分光透過率を $G(\lambda)$ ,光電変換素子の分 光感度特性を $D(\lambda)$ とすると,次式で与えられる<sup>3</sup>.

 Table 1
 Characteristics of chalcogenide optical fiber



Fig. 1 Spectral transmission loss of chalcogenide fiber and fluoride fiber

<sup>\*</sup> 原稿受付 平成2年3月19日

<sup>\*\*</sup> 正 会 員 金沢大学工学部(金沢市小立野 2-40-20)

<sup>\*\*\*</sup> 学生会員 金沢大学工学部

<sup>†</sup> 研削温度測定時のノイズなどの影響を考慮すると,実質的 には150℃以上の温度が測定可能である.









# $\Lambda = \int_{1}^{\lambda_2} \beta J(\lambda, T) F(\lambda) G(\lambda) D(\lambda) \, \mathrm{d}\lambda$

ただし、 $\beta$ は比例定数、 $\lambda_1 \sim \lambda_2$ は測定可能な波長範囲 である. InSb セルの長波長側のカットオフ値が5.5  $\mu$ m であることから、 $\lambda_2$ =5.5 $\mu$ m とおき、 $\lambda_1$ をパラ メータとして相対感度  $\Lambda$  を計算した結果が図2 であ る. 400°C 以下の温度では $\lambda_1$ を3 $\mu$ m より小さく設定 しても感度に大きな差を生じない.

### 2.2 出力校正

既知の温度に加熱された SiC から輻射される赤外 線をカルコゲナイド光ファイバで受光し,温度計の出 力電圧を測定した結果が図3である.ふっ化物光ファ イバを用いた場合に比べるとよく改善されており,約 25℃の温度を感知しているが,環境温度の影響や/ イズの問題があり,50℃以上を精度よく測定するこ とができると考えている.しかし,低い温度を測定で きるように感度を上げているため,400℃を越える高 温になると出力が飽和してしまう.また,図中の実線 は図2の理論曲線の中で最もよく実験結果と合う  $\lambda_1=3.6 \mu m$ の曲線を当てはめたものである.50℃以

Table 2 Characteristics of SiC

Density	3.13 g/cm <sup>3</sup>
Bending strength	590 MPa
Hardness	95.5 HRA
Thermal conductivity	80 W/mK

下の低温で少しはずれてはいるものの,全体的によく 一致している.

# 2.3 実験方法

実験装置は前報<sup>1)</sup> と同じである. 砥石周速度 V= 1570 m/min, テーブル速度 v=12 m/min, 切込み深 さ  $t=20 \mu$ m のもとで, 乾式上向きワンパス平面研削 を行い, SiC 内の温度分布, および研削抵抗を測定し た. 加工物の底面から研削表面近傍まであけた直径 0.6 mm の小穴に長さ約2 m のカルコゲナイド光ファ イバ1本を受光面が小穴の底面と接する位置まで挿入 する. 砥石が小穴の上を通過するとき,小穴の底面か ら輻射される赤外線をカルコゲナイド光ファイバで受 光し, InSb セルへ伝送して電気信号に変換する. 測 定信号はサンプリング間隔1 $\mu$ s でディジタルメモ リーに記録した後, パーソナルコンピュータで処理す る. 小穴が研削表面に貫通するまで測定を繰り返す.

研削抵抗は圧電素子型動力計上に加工物を取り付け,水平分力 F<sub>n</sub>,垂直分力 F<sub>n</sub>を測定した.

#### 2.4 実験材料

加工材料には常圧焼結した SiC(研削面形状:25×8 mm)を用いた.SiC の特性値を表2に示す.砥石 はレジンボンドダイヤモンド砥石(形状  $\phi$  200×10 mm,集中度:80,砥粒:#60/80,CSGII)である.

# 3. 実験結果

測定波形を図4に示す.加工物の研削表面から内部 への深さを  $Z \ge 1$  している.  $Z = 40, 20 \ \mu m$ における測 定結果であるが,鮮明な波形が得られており,十分な 精度で測定されていることがわかる.図より明らかな ように,数 ms の時間幅を持った温度変化はあるもの のパルス状の出力が全く測定されておらず,前報の Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub>(熱伝導率:13~29 W/mK)の場合の出力波 形と大きく異なっている.すなわち,本研究で用いた SiC は赤外線を透過しにくい性質を持ち,加工物内の 温度上昇に伴って小穴底面から輻射される赤外線だけ を測定していることになる.また,熱伝導の良い SiC でパルス状の出力が測定されなかったことから,前報 において測定されたパルス状の出力はすべて Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> 内を透過してきた赤外線によるものと判断できる.

さらに、HIP 焼結した Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> (熱伝導率: 29 W/ mK)の研削温度測定に本温度計を適用してみた.し



Fig. 4 Output waves of grinding temperature in surface layer of workpiece SiC  $V = 1570 \text{ m/min}, v = 12 \text{ m/min}, t = 20 \mu\text{m}, F_n = 92.4$  N,  $F_t = 17.6 \text{ N}$ 



Fig. 5 Output wave of grinding temperature in surface layer of workpiece Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>
V = 1570 m/min, v = 12 m/min, t = 30 μm, F<sub>n</sub> = 159 N, F<sub>t</sub>=27.0 N

かし、 $Al_2O_3$  は熱伝導が悪く、しかも $Si_3N_4$  ほど研 削抵抗が大きくならないことから、加工条件をt=30 $\mu$ m と過酷にしているにもかかわらず図5 にみるよう に加工物内の温度は高 $450^\circ$ C 程度にしか上がらず、 この温度計でも測定が難しい、今後ノイズを減らすな どの工夫を要する、また、 $Al_2O_3$  は $Si_3N_4$ より赤外線 をよく透過するため、砥石が穴の上部を通過するはる か以前からパルス状の出力が検出されており、このパ ルスが温度測定の妨害となっている.

図4の結果から、加工物内の温度分布を求めた結果 が図6である. Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub>よりも被削性が良いため研削抵 抗が小さく温度ははるかに低い. 研削表面下 Z=40 $\mu$ m ですでに 100°C 以下となっている. また、熱伝導 率が Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub>よりはるかに大きいため、温度降下勾配 も小さくなり、研削表面 (Z=0  $\mu$ m)の温度も低いと 推定できる.

#### 4. 結 言

石英光ファイバやふっ化物光ファイバより長波長の 赤外線を伝送できるカルコゲナイド光ファイバと高速 光電変換素子 InSb を組み合わせた赤外線輻射温度計 によって、常圧焼結した SiC の研削温度測定を試み たところ、この材料の赤外線を透過しにくい性質も手



Depth below the ground surface  $Z = \mu m$ 

Fig. 6 Temperature distribution in surface layer of workpiece SiC

 $V = 1570 \text{ m/min}, v = 12 \text{ m/min}, t = 20 \ \mu\text{m}, F_n = 92.4 \text{ N}, F_t = 17.6 \text{ N}$ 



Fig. 7 Output wave of grinding temperature of workpiece SiC using InSb-I. R. P. with fluoride fiber V = 1570 m/min, v = 12 m/min,  $t = 40 \mu$ m,  $F_n = 154$ N,  $F_i = 28.4$  N

伝って,加工物内の温度分布を精度良く測定できるこ とができた.

終わりに、カルコゲナイド光ファイバ、ふっ化物光 ファイバ、およびセラミックスの提供を受けた非酸化 物ガラス研究開発(株)山岸隆司氏、NTT、および日 本タングステン(株)に深謝する.

## [付 録]

SiC を加工したときの研削温度をふっ化物光ファイ バ型赤外線輻射温度計で測定し、コア径の影響を調べ た結果が図7である.加工条件をt=40 µm と過酷に しているにもかかわらず、この温度計の測定限界に近 い温度にしか上昇していないため、ノイズの多い波形 となっている.しかし、コア径50 µm の光ファイバ を用いてもパルス状の出力が検出されていないことが 確認できる.

# 参考文献

- 上田隆司、山田啓司、杉田忠彰:ふっ化物光ファイバを 用いた赤外線輻射温度計による常圧焼結 Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> の研削温 度測定、精密工学会誌、56,8(1990)1452.
- 山岸隆司:赤外線透過用カルコゲナイドガラスファイバ, New Glass, 3, 4 (1989) 10.
- T. Ueda, A. Hosokawa and A. Yamamoto: Studies on Temperature of Abrasive Grains in Grinding - Application of Infrared Radiation Pyrometer, ASME, J. Engg. Ind., 107, (1985) 127.